

证券代码：600076

公司简称：康欣新材

康欣新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2026-02

投资者关系活动类别	业绩说明会
活动主题	康欣新材 2025 年年度暨 2026 年第一季度业绩说明会
时间	2026-06-03 - 10:00-11:00
地点/方式	上证路演中心 https://roadshow.sseinfo.com 视频录播+网络文字互动
参会人员	董事长：邵建东 董事、总经理：汤晓超 董事、副总经理、财务总监、董事会秘书：黄亮 独立董事：冯凯燕
投资者关系活动主要内容介绍	<p>投资者关系活动主要内容</p> <p>1、黄总你好：伴随宇邦半导体正式并入上市公司，麻烦介绍标的目前实际产能投产水平，依托现有订单与排产计划，管理层对全年业绩目标达成怎么看？</p> <p>答：您好，关于宇邦半导体的具体订单及业绩情况，请关注公司后期披露的定期报告。感谢您对公司的关注！</p> <p>2、碳交易这块能否给公司带来收益？估计多久、多少？</p> <p>答：您好，林业碳汇收益受国家政策机制、碳价、开发进度等多重因素影响，存在不确定性。目前碳汇尚未给公司带来实质性的收益，公司将密切跟踪全国碳市场与林业碳汇政策进展，积极盘活生态资源价值，相关重大进展将严格按照监管要求履行信息披露义务。感谢您对公司的关注！</p> <p>3、请问公司未来利润点在哪里？</p>

答:您好,公司未来利润来源分阶段稳步布局,短期以集装箱主业提质增效,同时加快推进低效林地资产盘活改善经营、减少亏损拖累,通过资产处置回款压降负债与降低财务费用,增厚阶段性收益;中期依托控股宇邦半导体逐步完成客户认证与产能释放,深挖半导体精密零部件配套订单形成增量营收,叠加公司集装箱地板业务形成双主业增强盈利能力,提高公司核心竞争力;长期在稳妥整合现有两项业务基础上,探索集装箱主业与半导体配套材料协同机会,同时依托控股股东等各种资源开展产业整合。上述各项业务盈利释放节奏受行业周期、客户落地、项目整合进度等因素影响存在不确定性,后续经营进展请以公司公告为准。感谢您对公司的关注!

4、您好,公司传统木业业务已经连续多年大额亏损,从今年一季度可以看出亏损仍在持续,对公司业绩形成严重拖累。虽然公司收购了宇邦半导体,未来有望贡献利润,但短期看,宇邦的收益大概率仍不足以覆盖传统木业所产生的亏损缺口。那么请问:公司除了发展半导体第二增长极外,针对传统木业业务本身,有没有减少产能、关停低效产能,或者降本增效之类的明确计划或目标?第二,公司已在处置部分林地资产,后续资产处置的回笼资金用途是什么?是偿还有息负债、减少财务费用,或者有没有计划投入到新进的半导体业务用来扩大规模。第三,除了宇邦之外,有没有进一步的产业整合、资产注入或剥离不良资产的计划,以便于改善长期亏损的局面。谢谢。

答:您好,关于上述几个问题,公司将做好以下几个方面,一是持续优化集装箱地板业务,稳固现有航运、铁路运输集装箱客户的同时,加强产品研发丰富产品品类、拓展新客户、提升市场份额;通过持续深化生产体系改革,推进智能化升级,持续压降成本,力争主业毛利率稳步回升;二是公司处置部分林地资产是为了盘活存量低效资产、优化资产结构、压降资产负债率,目前暂无扩大半导体业务规模的计划。公司后续如有产业调整的计划或进展,相关事宜将会进行公告。感谢您对公司的关注!

5、网上传海力士（无锡）、长鑫配套代工厂、华润微、中芯、华虹无锡等单位与宇邦半导体公司存在着业务往来，请确认一下。

答：您好，公司会严格按照监管规则履行相应审议程序及信息披露义务，请关注后续披露的定期报告。感谢您对公司的关注！

6、这批林地拍卖进展感觉有点慢，请问有没有加大宣传，通过多个平台去卖？

答：您好，林地处置会经历挂牌、摘牌、签署转让协议、林权变更等步骤。林地已在江苏省产权交易所公开挂牌，并同步通过上交所公告、产权交易平台多渠道进行披露。感谢您对公司的关注！

7、董事长，山东证监局要求《改正存在问题的报告》已经提交了没有？

答：您好，相关报告已按期、正常提交，感谢您对公司的关注！

8、市场对公司半导体并购与国资赋能转型预期较高，但当前市值尚未充分体现业务升级价值，请问管理层如何看待公司现阶段估值水平？新材料与半导体业务是否会成为核心增长极、重塑公司盈利逻辑？除已披露事项外，公司目前是否存在初步接洽或规划中的资产整合、产业合作筹备工作？

答：您好，二级市场估值受宏观经济、行业政策、市场情绪等多重因素影响。目前公司紧抓集装箱主业经营提质增效，依托半导体业务增量优化盈利基本面，二者共同作为公司核心增长引擎，持续优化原有盈利结构、重塑公司盈利逻辑。除已公开披露事项外，公司目前暂不存在资产整合等事项。后续若开展相关重大事项，公司将严格按照监管规则及时履行信息披露义务。感谢您对公司的关注！

9、邵董事长您好，想向您请教三个问题：一是公司 2026 年度半导体业务全年订单落地及业绩预期情况如何，相关业务板块的发展规划与盈利目标是否明确；二是立足中长期发展，公司是否存在重组、资产整合等资本运作相关规划；三是当前公司股价长期低迷，市场信心偏弱，请问管理层后续有无具体的市值管理举措，以及提

振投资者信心、维护股东权益的相关安排？

答：您好，半导体业务方面，无锡宇邦半导体已从 2026 年 4 月起纳入公司合并报表，具体订单及业绩情况，请关注公司后期披露的定期报告；资本运作方面，公司未来如筹划相关资本运作事项，将严格依规履行审议及信息披露程序；针对公司股价低迷、市场信心不足的问题，公司管理层高度重视，一方面紧抓集装箱主业经营提质增效，依托半导体业务增量优化盈利基本面，另一方面持续做好投资者沟通与信息披露工作，通过多措并举稳步修复市场信心，切实维护全体股东合法权益。感谢您对公司的关注！